

CoolBox

PASTAS TÉRMICAS

COMPOSICIÓN ELÉCTRICAMENTE NO CONDUCTORA Y DE BAJA RESISTENCIA TÉRMICA.

IDEAL PARA MEJORAR LA TRANSFERENCIA DE CALOR ENTRE CPUS, MEMORIA, CHIPSETS GRÁFICOS Y SOLUCIONES DE REFRIGERACIÓN, CONSIGUIENDO DE ESA FORMA UNA REFRIGERACIÓN MÁS EFICIENTE.

H70 3.17W/m-K /2g. y 30g. silver

Conductividad térmica: $> 3.17 \text{ W/m-k}$.
Resistencia térmica: $< 0.067^{\circ}\text{C-in}^2 / \text{W}$.
Temperatura de funcionamiento: $-30 \sim 240^{\circ}\text{C}$.

COMPUESTOS SILICONA 30%.
COMPUESTOS CARBÓN 20%.
ÓXIDOS METÁLICOS 50%.

H80 5.15 W/mK/4g., 6g. y 30g. grey

Conductividad térmica: $> 5.15 \text{ W/m-k}$
Resistencia térmica: $< 0.004^{\circ}\text{C-in}^2 / \text{W}$
Temperatura de funcionamiento: $-30 \sim 280^{\circ}\text{C}$

COMPUESTOS SILICONA 30%.
COMPUESTOS CARBÓN 20%.
ÓXIDOS METÁLICOS 50%.

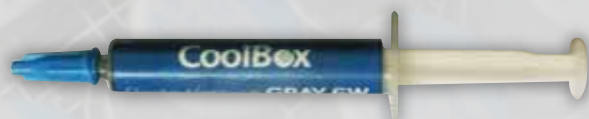
H88 6.0W/m-K / 2 x 1g. grey

Conductividad térmica: $> 6.0 \text{ W/m-K}$
Resistencia térmica: $< 0.0036^{\circ}\text{C-in}^2/\text{W}$
Temperatura de funcionamiento: $-30 \sim 150^{\circ}\text{C}$



X80 6 W/m-K - 2g. grey

Conductividad térmica: $> 6.0 \text{ W/m-k}$
Resistencia térmica: $< 0.0036^{\circ}\text{C-in}^2 / \text{W}$
Temperatura de funcionamiento: $-30 \sim 150^{\circ}\text{C}$



CoolBox



Elements

THERMAL CLEANER Limpiador térmico

KIT DE LIMPIEZA FORMADO POR 2 SOLUCIONES LÍQUIDAS

(disolvente y purificador) indicado para limpiar superficies y dejarlas preparadas para la aplicación sobre las mismas de pasta térmica. Cada solución se presenta en una botella de 30ml.

COMUPUESTO POR:

Solución 1 (disolvente): Preparado específico que permite eliminar fácilmente restos de grasa o pasta térmica. Tras aplicarlo, un paño permitirá retirar los restos de forma sencilla.

Solución 2 (Purificador): Solución que elimina cualquier resto sobre la superficie, para dejarla preparada para una aplicación óptima de pasta térmica.

Paño de limpieza: Útil para separar los restos de pasta térmica que la solución disolvente permitirá desprender con facilidad.



THERMAL PAD Almohadilla térmica

DISEÑADA PARA MEJORAR LA REFRIGERACIÓN DE CPU, GPU O CHIPSETS DE FORMA SENCILLA Y LIMPIA

La almohadilla, situada entre la fuente de calor y el elemento disipador/refrigerador permite una alta transferencia de calor entre ambos, gracias a su alta conductividad y baja resistencia térmica.

Temperatura de funcionamiento: $-30^{\circ}\text{C} \sim 240^{\circ}\text{C}$

Conductividad térmica $> 3.17\text{W/m}\cdot\text{K}$.

Resistencia térmica $< 0.067^{\circ}\text{C}\cdot\text{in}^2/\text{W}$.

Color: Azul.

Dimensiones: 30x30x1 mm.

